



2027年 3 月期 第 1 四半期決算

伯東株式会社
2026年8月12日

連結業績概要

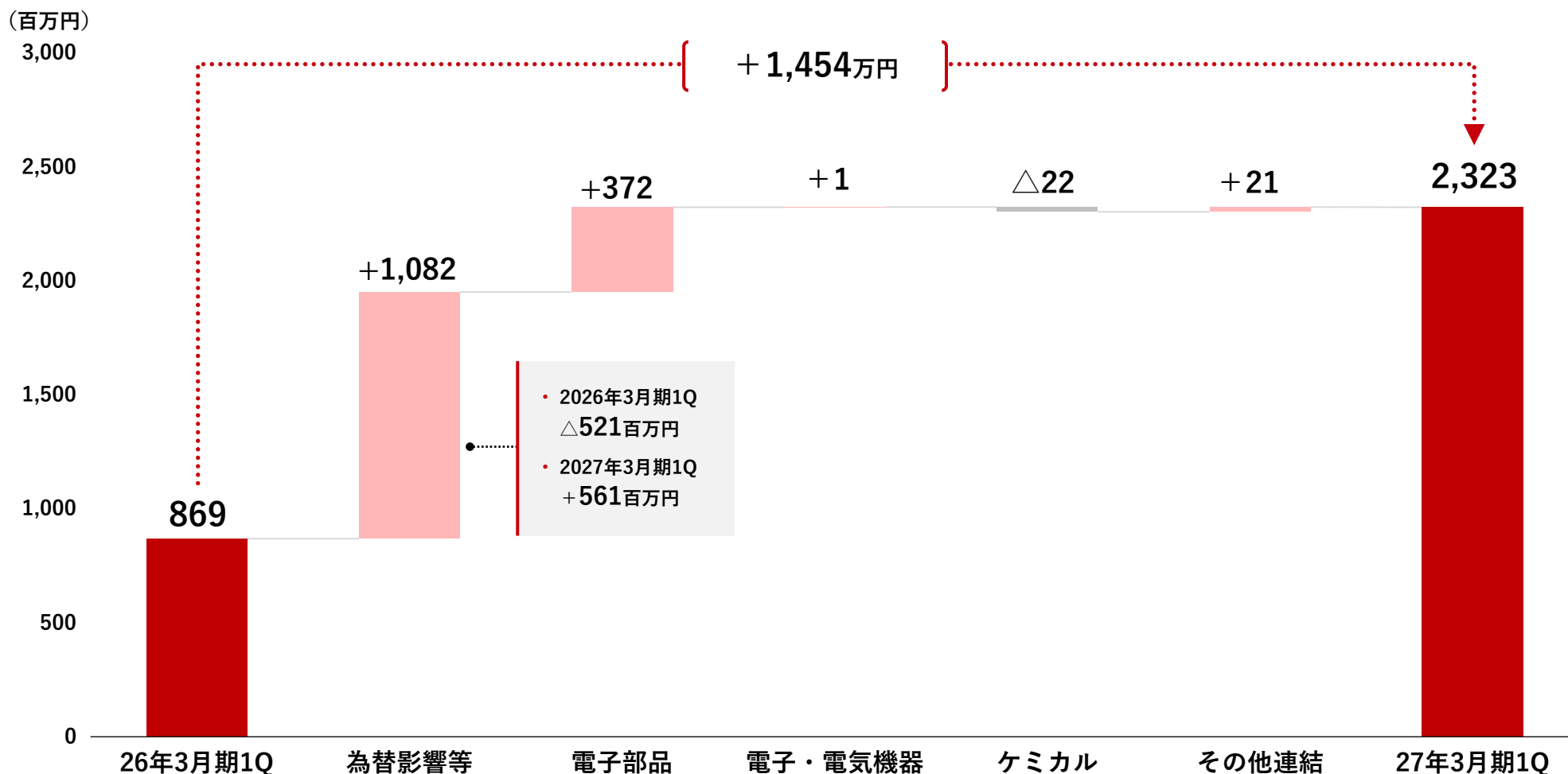
- 新規連結子会社の損益寄与や車載関連用途が堅調に推移したこと等により、売上高、売上総利益、営業利益ともに増収増益。為替差益の計上もあり経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益、EPSも前年同期比で増加

(百万円)	2026年3月期 第1四半期	2027年3月期 第1四半期	前年同期比		
			増減額	増減率	
売上高	40,337	54,537	+14,199	+35.2%	・ 車載向け半導体・液晶モジュール関連が堅調、Rabyte2社の寄与
売上総利益	5,748	7,989	+2,241	+39.0%	・ 売上総利益率は前年同期より改善 前年1Q 14.3% ⇒ 当1Q 14.6%
営業利益	869	2,323	+1,454	+167.3%	・ 販管費はYoY7.8億円増 (Rabyte2社の販管費および同社に係るのれん償却費等)
経常利益	719	2,295	+1,575	+219.1%	・ 支払利息は同2億円増加 ・ 前年1Qは為替差損1.7億円、当1Qは為替差益1.6億円を計上
親会社株主に帰属する四半期純利益	659	1,462	+803	+121.8%	・ 政策保有株式の売却により投資有価証券売却益2.8億円を計上
EPS※	35.03	77.67	+42.64	—	

※ EPS：1株当たり当期純利益

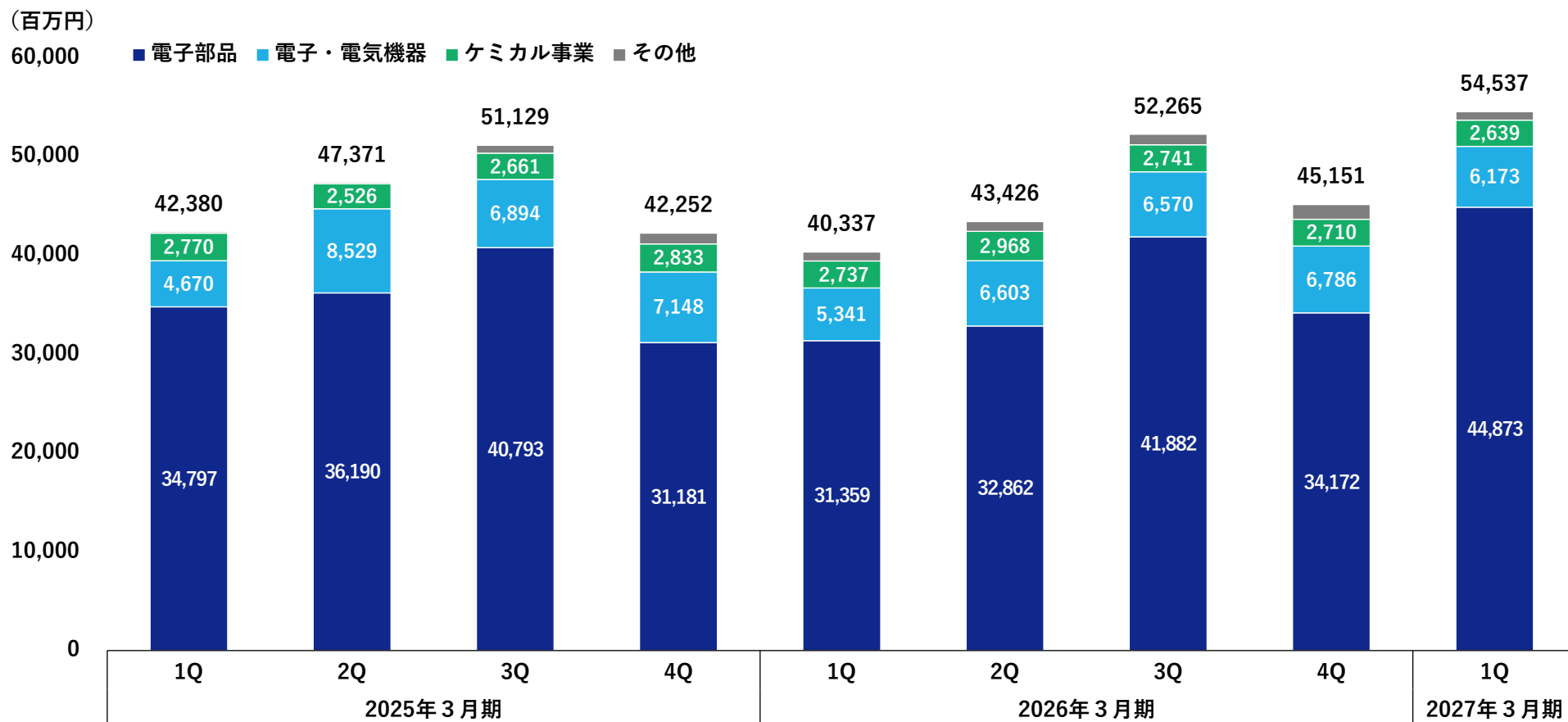
連結営業利益の増減要因（対前年同期比）

- 前年1Qは為替変動(円高)により5.2億円のマイナス、当1Qは円安により5.6億円の利益押し上げ
- 電子部品は新規連結子会社の利益貢献もあり増益、ケミカルは化粧品基剤出荷減により減益



連結売上高の四半期推移

- 電子部品：車載向け、産業機器向け等が伸長。新規連結子会社による売上寄与も加わり2四半期ぶりの高水準で推移。AI・データセンター関連投資や5G投資を背景に、光部品も堅調
- 電子・電気機器：半導体・パッケージ関連の設備投資拡大を背景に、PCB製造関連機器が伸長。前期に獲得した案件の売上化が進み、前年同期比で増収
- ケミカル：石油・石化分野は概ね前期並みに推移する一方、海外向け化粧品基剤は出荷減により減少



セグメント別業績

- 電子部品は新規連結子会社の損益寄与や為替影響により増収増益
- ケミカルは海外向け化粧品基剤が前年を下回り減収減益

(百万円)		2026年3月期 第1四半期	2027年3月期 第1四半期	前年同期比	
				増減額	増減率
電子部品	売上高	31,359	44,873	+13,513	+43.1%
	セグメント利益	521	2,021	+1,499	+287.3%
電子・ 電気機器	売上高	5,341	6,173	+832	+15.6%
	セグメント利益	418	430	+11	+2.8%
ケミカル	売上高	2,737	2,639	△ 97	△3.6%
	セグメント利益	151	136	△ 15	△10.1%
その他	売上高	1,000	948	△ 51	△5.2%
	セグメント利益	△ 370	△ 325	+44	△12.1%
合計	売上高	40,438	54,635	+14,196	+35.1%
	セグメント利益	721	2,262	+1,540	+213.5%

電子部品

- ・ 車載、産業機器、光部品も堅調に推移、Rabyte2社の損益寄与や為替影響もあり増収増益

電子・電気機器

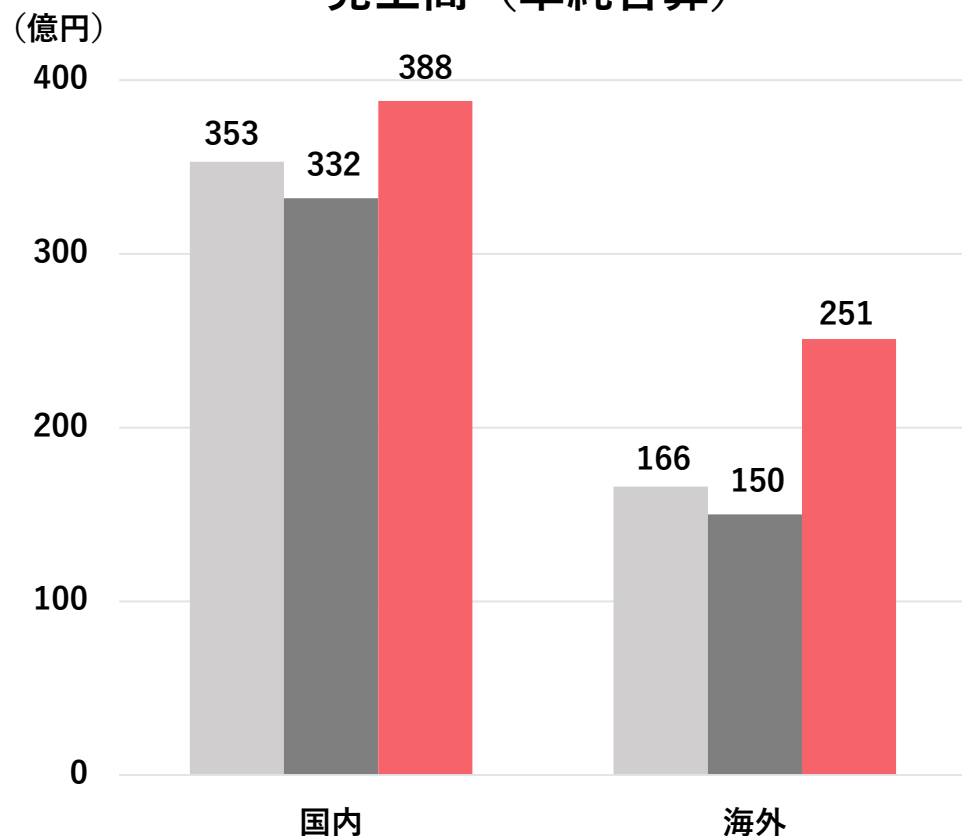
- ・ 半導体、AI・データセンター関連の設備投資拡大を背景に、PCB製造関連機器が伸長し、増収増益

ケミカル

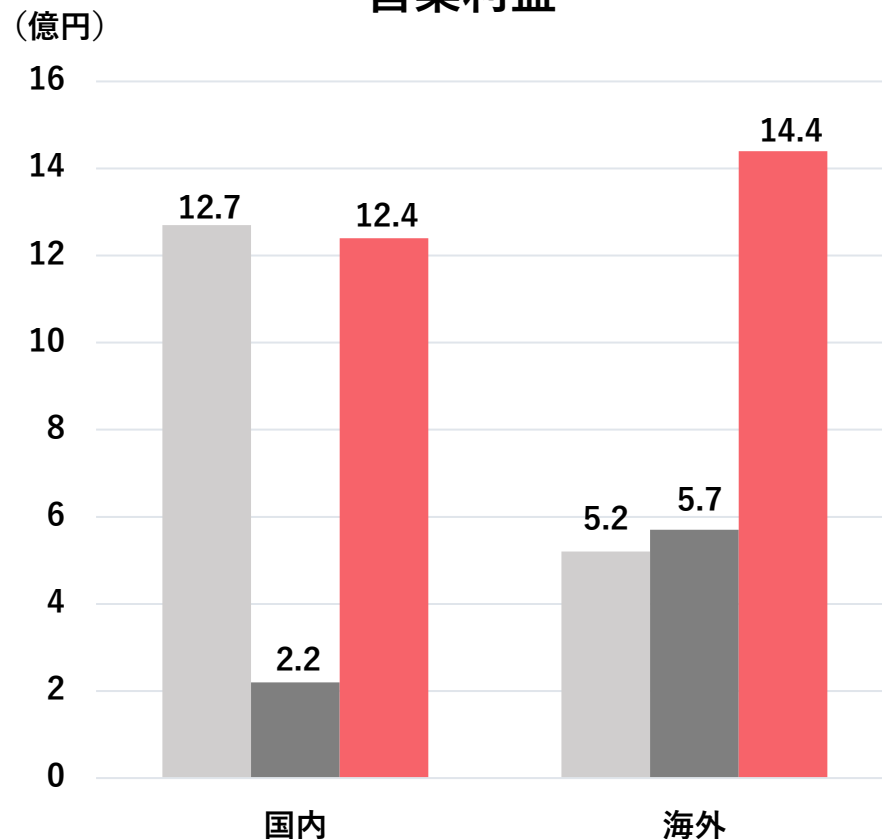
- ・ 石油・石化、紙パルプ分野は前年並みも海外向け化粧品基剤が前年を下回り、減収減益

※売上高はセグメント間内部取引消去前（同一セグメント内取引は相殺済）の金額

売上高（単純合算）



営業利益



国内（伯東＋連結子会社3社）

伯東、モルデック、HAL、クリアライズ

海外（連結子会社11社）：

伯東香港、上海、台湾、シンガポール、タイランド、

Rabyte Edge、Rabyte 他4社

■ 25/3期 1Q実績 ■ 26/3期 1Q実績 ■ 27/3期 1Q実績

連結貸借対照表

- 現預金、売上債権の増加等により、総資産は35億円の増加
- 仕入債務の増加等により、総負債は26億円の増加
- その他有価証券評価差額金と為替換算調整勘定の増加等により、純資産は9億円の増加

(百万円)	2026年3月期	2027年3月期 第1四半期	増減額	
総資産	164,484	168,044	+3,560	
現預金	18,957	20,154	+1,197	●..... 連結CF参照
売上債権	56,868	59,189	+2,321	●..... 売上の増加に伴う増加
棚卸資産	46,311	46,161	△ 150	
のれん	16,063	15,761	△ 302	●..... 償却による減少
投資有価証券	8,557	9,561	+1,004	●..... 保有株式の株価上昇による増加
総負債	94,651	97,316	+2,665	
仕入債務	22,551	25,412	+2,861	
有利子負債	58,031	57,721	△ 310	●..... 短期借入金の増加、長期借入金の返済
純資産	69,833	70,728	+895	●..... 保有株式の株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加
自己資本比率	41.6%	41.2%	—	●..... 為替変動による為替換算調整勘定の増加

キャッシュ・フロー計算書

- 仕入債務の増加等により、営業キャッシュ・フローは31億円の収入
- 投資有価証券の売却等により、投資キャッシュ・フローは0.6億円の収入
- 借入金の返済や配当金の支払い等により、財務キャッシュ・フローは23億円の支出

(百万円)	2026年3月期 第1四半期	2027年3月期 第1四半期	増減額	
営業キャッシュ・フロー	4,430	3,128	△ 1,302	・ 税前利益+26億円、売上債権の増加△19億円、棚卸資産の減少+3.5億円、仕入債務の増加+27億円
投資キャッシュ・フロー	175	55	△ 120	・ 投資有価証券の売却+3億円、有形・無形固定資産の取得△1.4億円、定期預金への預入△1億円
財務キャッシュ・フロー	△ 3,732	△ 2,354	+1,378	・ 短期借入金の増加(純額)+15億円、長期借入金の返済△20億円、配当金の支払△18億円
換算差額	88	254	+166	
現金・現金同等物の増減額	961	1,083	+122	
現金・現金同等物の 期末残高	15,891	19,833	+3,942	

2027年3月期 連結業績予想

- 期初公表の業績予想を2026年7月29日に上方修正
- AI・データセンター市場の活況により、産業機器向け半導体・通信用光部品・コネクタ等の需要が増加傾向、真空機器・PCB製造関連機器への引き合いも大幅に増加し、一部は当期中の売上計上を見込む
- 売上高の増加および円安による利益率改善等により、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回予想を上回る見込み

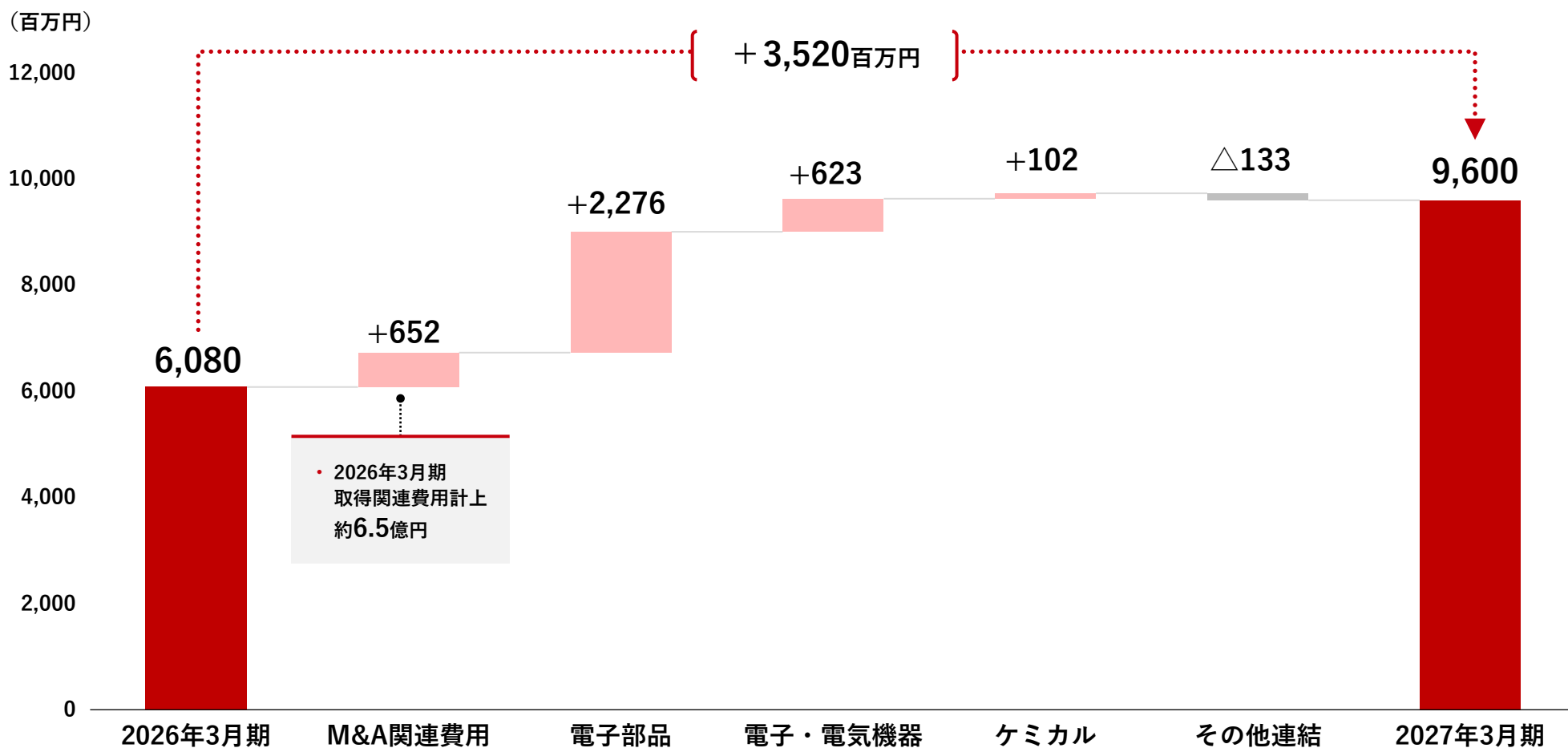
(百万円)	2026年3月期	2027年3月期			前年比	
	実績	上期(予)	下期(予)	通期	増減額	増減率
売上高	181,178	111,500	116,000	227,500	+46,322	+25.6%
売上総利益	28,080	16,400	18,400	34,800	+6,720	+23.9%
営業利益	6,080	3,900	5,700	9,600	+3,520	+57.9%
経常利益	5,579	3,600	5,000	8,600	+3,021	+54.1%
当期純利益	5,009	2,600	3,800	6,400	+1,391	+27.7%
EPS [※]	266.14円	—	—	339.95円	73.81円	—
ROE	7.5%	—	—	9.3%	1.8pt	—

※ EPS：1株当たり当期純利益

※ 1株当たり当期純利益は株式分割前の株式数で計算しております。

連結営業利益の増減要因（対26/ 3 期実績比）

- 電子部品は、AI・データセンター市場の活況による需要増加に加え、新規連結子会社2社の損益寄与および円安による利益率改善の継続により増益を見込む
- 電子・電気機器は、真空機器・PCB製造関連機器への引き合いが増加し、増益を見込む
- 2026年3月期はM & A 関連費用6.5億円を計上



2027年 3 月期配当予想

- 期初公表の配当予想を2026年7月29日に修正（増配）
- 連結業績予想の修正、安定的な利益成長および市場からの期待等を踏まえ、中間配当予想を1株当たり120円に、また、株式分割(3分割)に伴い期末配当予想を45円（分割前換算135円）に修正
- 年間配当金は分割前換算で255円、連結配当性向は75.0%を見込む

			2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期	
					配当予想	(株式分割前換算)
1株当たり配当金	中間	(円)	130	100	120	(一)
	期末	(円)	130	100	45	(135)
	年間	(円)	260	200	—	(255)
配当金総額	年間	(百万円)	4,892	3,765	—	
配当性向		(%)	95.3	75.1	75.0	
純資産配当率 (DOE)		(%)	7.4	5.6	6.9	

- ・ 株式分割前換算で255円を予想
- ・ 株式分割：2026年10月1日付けで3分割

「令和 8 年熊本地震」の影響

- 自社ブランドPCB製造関連機器のサブストレート投影露光装置（ステッパー）が製造委託先の熊本県八代市の協力会社へ預託中に被災
- 現在、同社に預託、設置している当社の棚卸資産および固定資産の詳細な被害状況を確認中
- 当該資産の四半期連結貸借対照表上の計上額は以下のとおり

(百万円)	主な内容	2027年3月期 第1四半期末時点
商品及び製品	ステッパー用投影レンズ、照明ユニット、本体など	1,340
有形固定資産	クリーンブース、クリーンルーム、架台、治具など	91
合 計		1,432

今後の事業活動や業績に与える影響につきましては、開示すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせいたします。



IRに関するお問い合わせ先

経営企画部  03-3225-8931

本資料にて記載されているデータ及び将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により変化する可能性があります。従いまして、本資料は記載された目標・予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。